

2024年度 第3四半期 決算説明資料

2025.1.23

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

| (単位：百万円) | FY2024 3Q |
|----------|--------------|
| 売上高 | 93,553 |
| 売上総利益 | 66,622 |
| GP率 | 71.2% |
| 販売管理費 | 27,476 |
| 営業利益 | 39,145 |
| 経常利益 | 42,027 |
| 経常利益率 | 44.9% |
| 税前利益 | 41,866 |
| 純利益 | 31,809 |

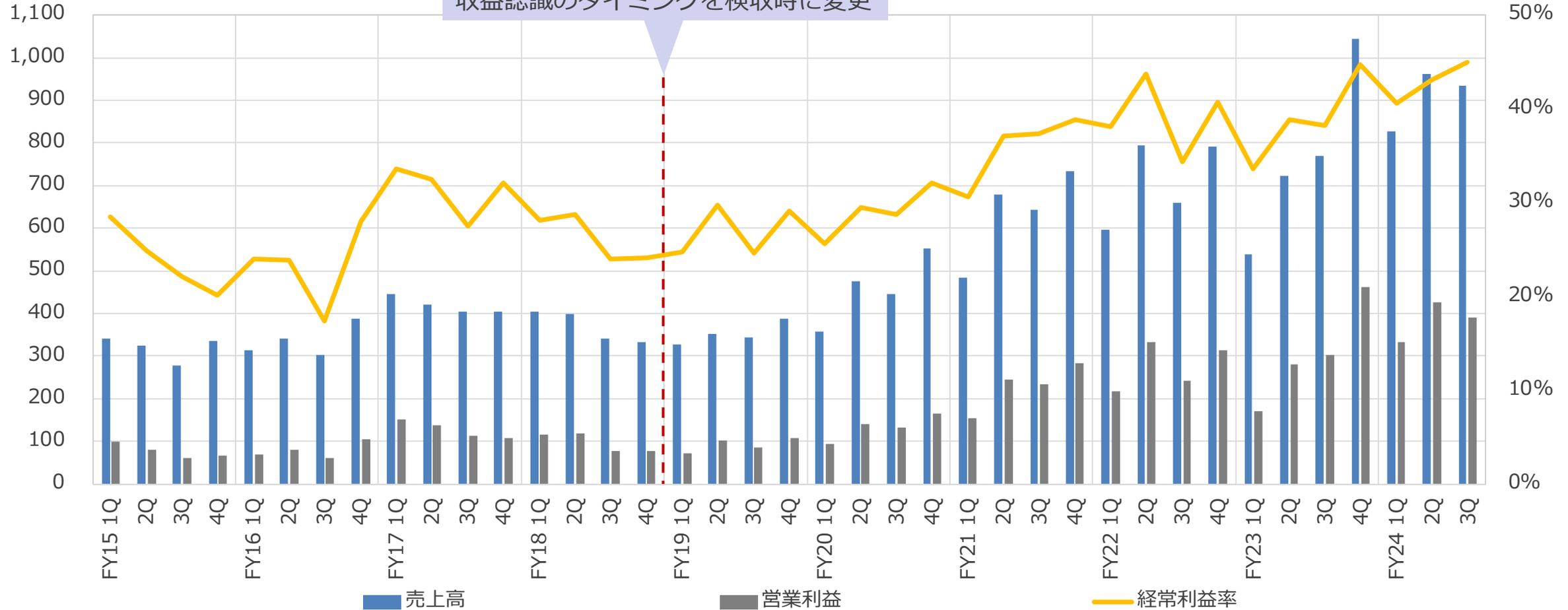
| FY2024 2Q | QoQ | |
|--------------|--------|-------|
| | 差額 | (%) |
| 96,243 | -2,691 | -2.8% |
| 69,029 | -2,407 | -3.5% |
| 71.7% | -0.5p | - |
| 26,454 | 1,022 | 3.9% |
| 42,575 | -3,430 | -8.1% |
| 41,429 | 598 | 1.4% |
| 43.0% | 1.9p | - |
| 41,317 | 549 | 1.3% |
| 29,729 | 2,080 | 7.0% |

| FY2023 3Q | YoY | |
|--------------|--------|-------|
| | 差額 | (%) |
| 76,995 | 16,558 | 21.5% |
| 52,654 | 13,968 | 26.5% |
| 68.4% | 2.8p | - |
| 22,300 | 5,176 | 23.2% |
| 30,353 | 8,792 | 29.0% |
| 29,449 | 12,578 | 42.7% |
| 38.2% | 6.7p | - |
| 21,876 | 19,990 | 91.4% |
| 16,071 | 15,738 | 97.9% |

売上高： YoY 高水準の出荷と検収の進捗、加えて為替影響により増加
 GP率： YoY 高付加価値製品の寄与および為替影響により上昇
 販売管理費： YoY 人件費や研究開発費を中心に増加

(単位：億円)

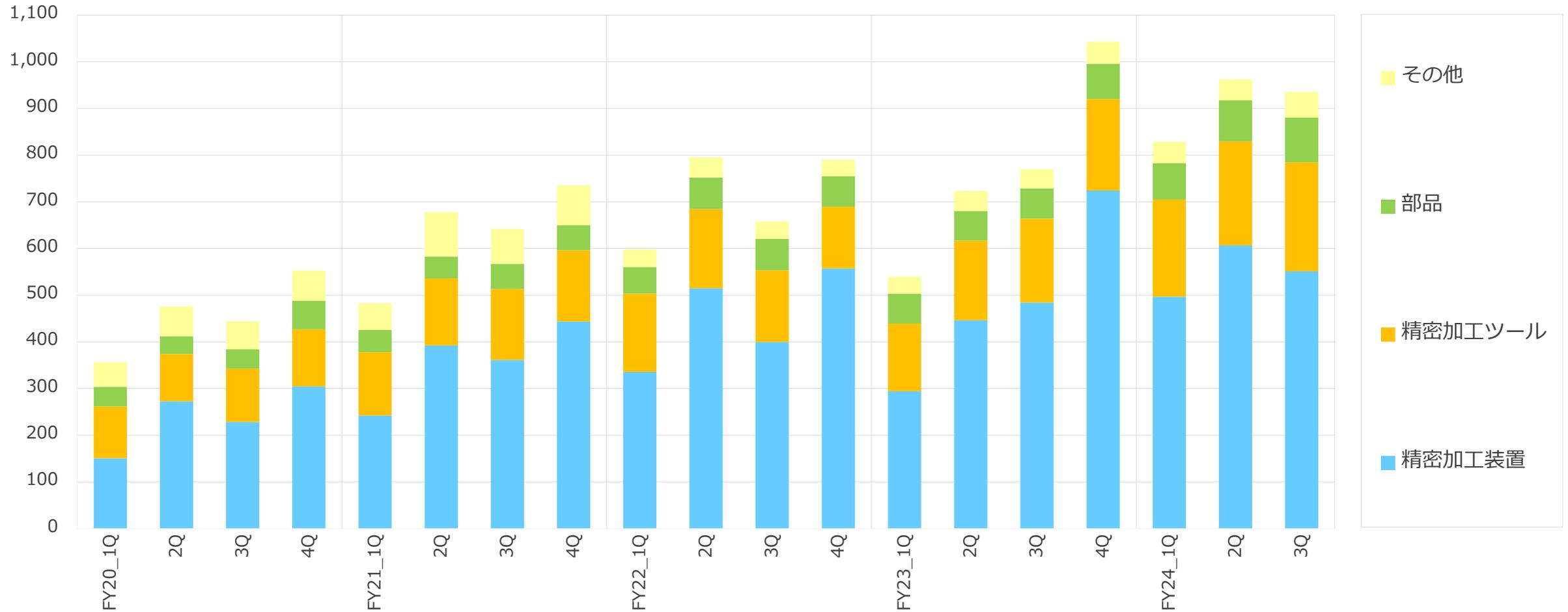
会計方針変更により
収益認識のタイミングを検収時に変更



高いG P率を背景に経常利益率は四半期最高を記録
(FY24_3Q 営業利益率41.8% 経常利益率44.9% 純利益率34.0%)

製品群別売上高 四半期推移

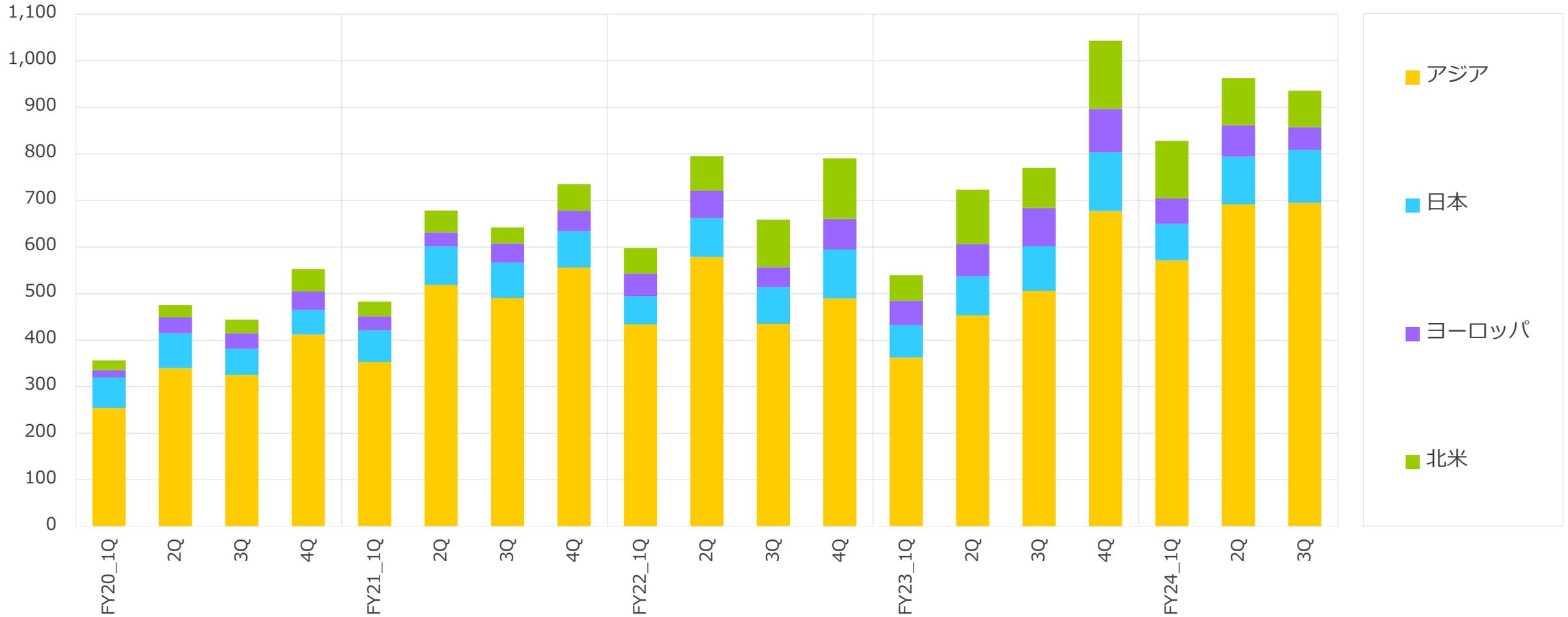
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

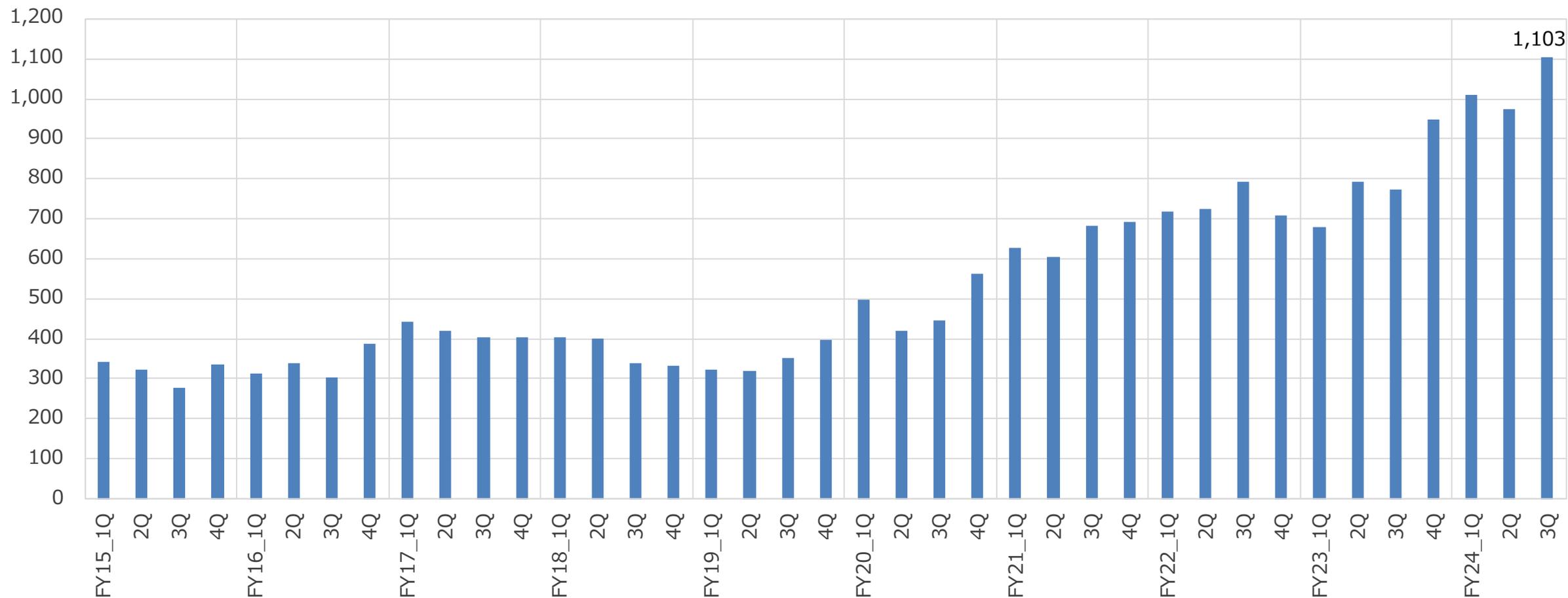
地域別売上高 四半期推移

(単位：億円)



FY24_3Q 海外売上高比率 87.8%

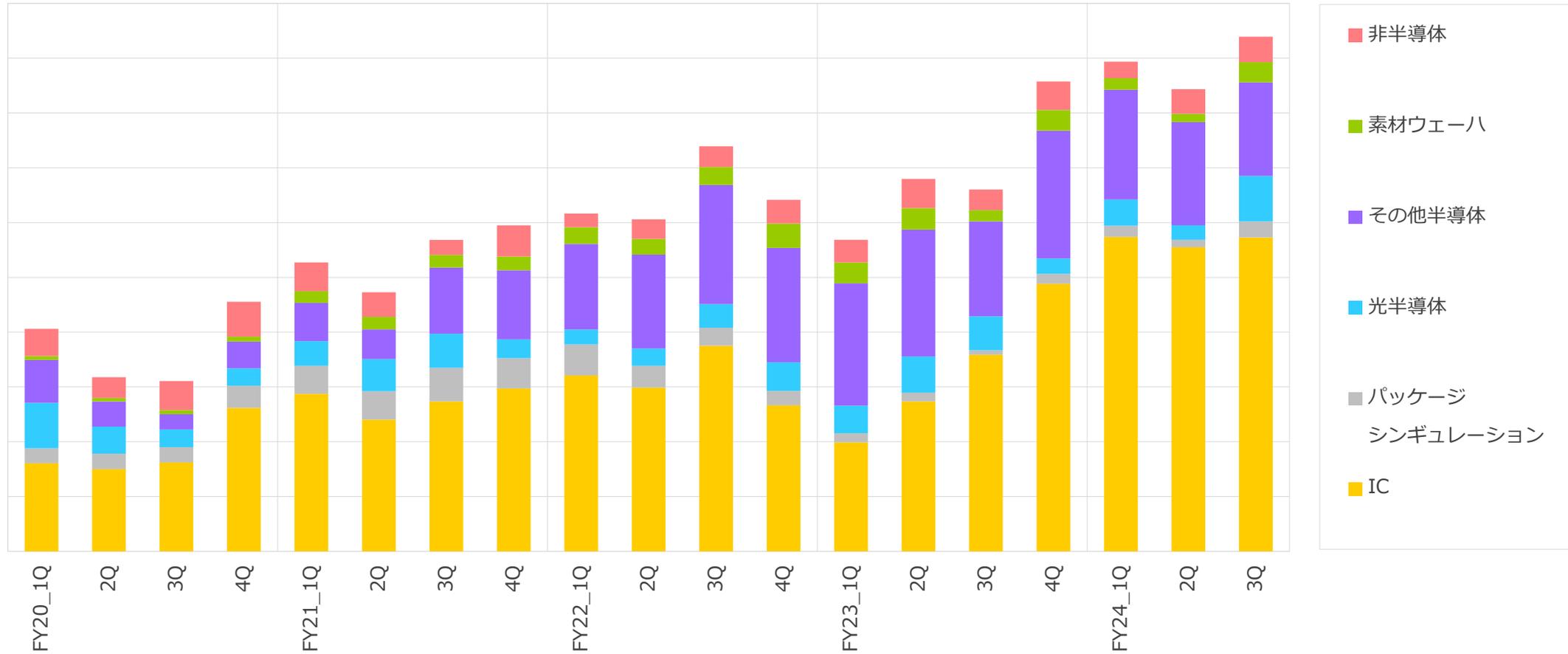
(単位：億円)



FY24_3Q 出荷額 約1,103億円
(四半期最高を記録)

出荷額ベース

精密加工装置

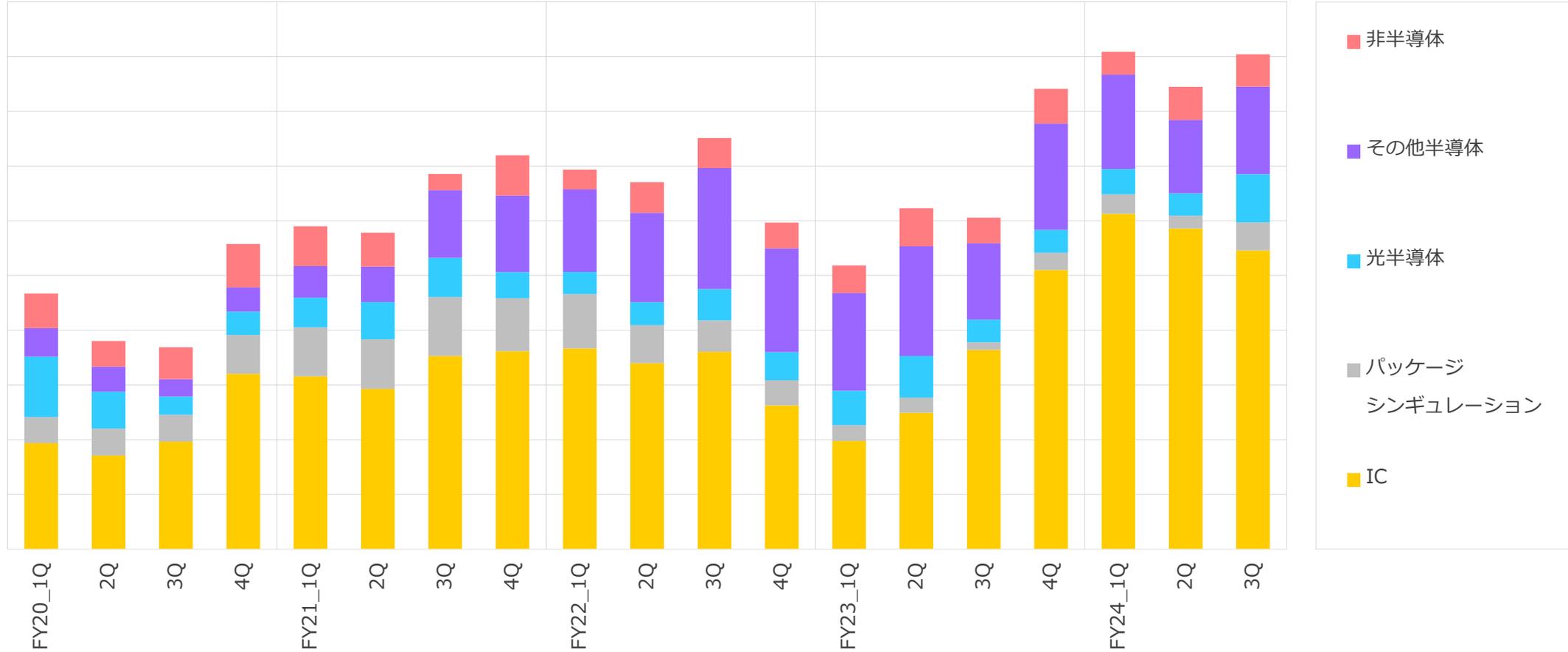


QoQ
YoY

生成AI向けを中心にIC向けが高水準を維持
生成AIの需要拡大を背景にIC向けが増加

出荷額ベース

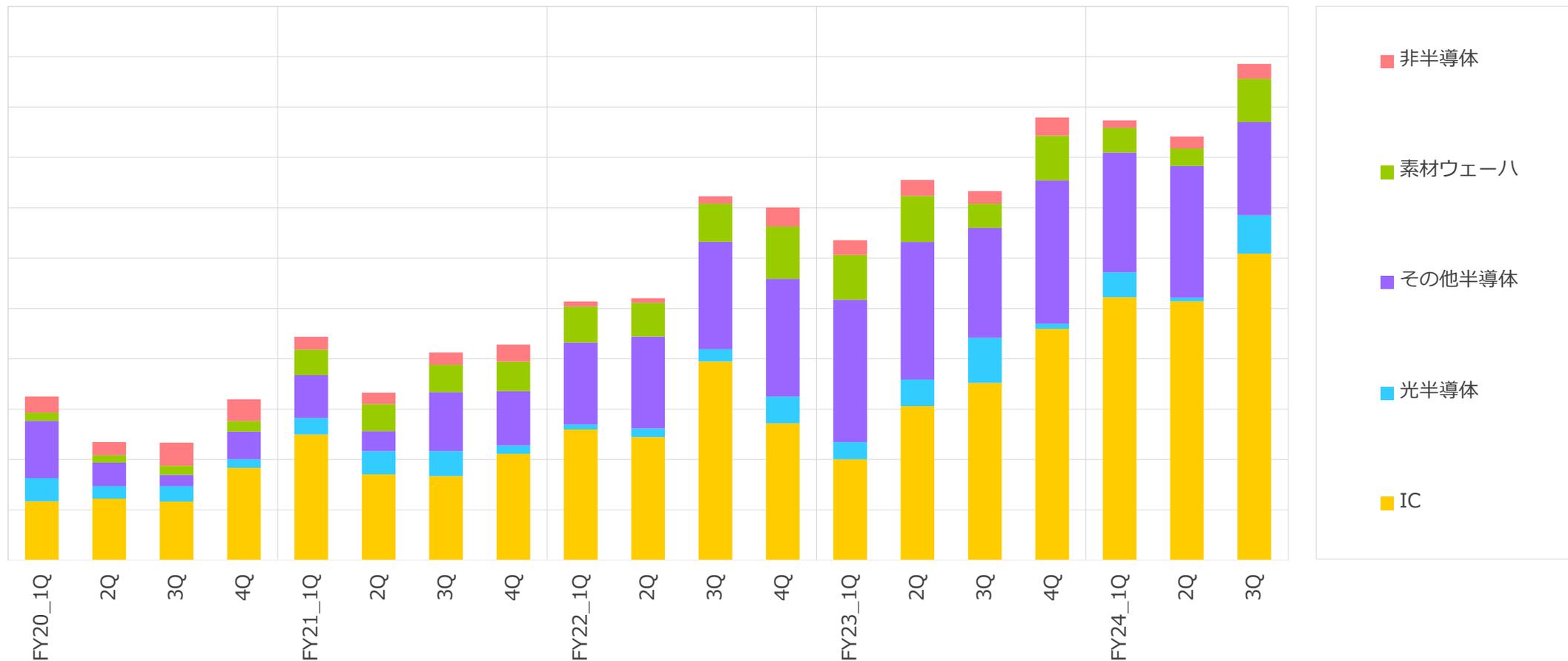
ダイサ



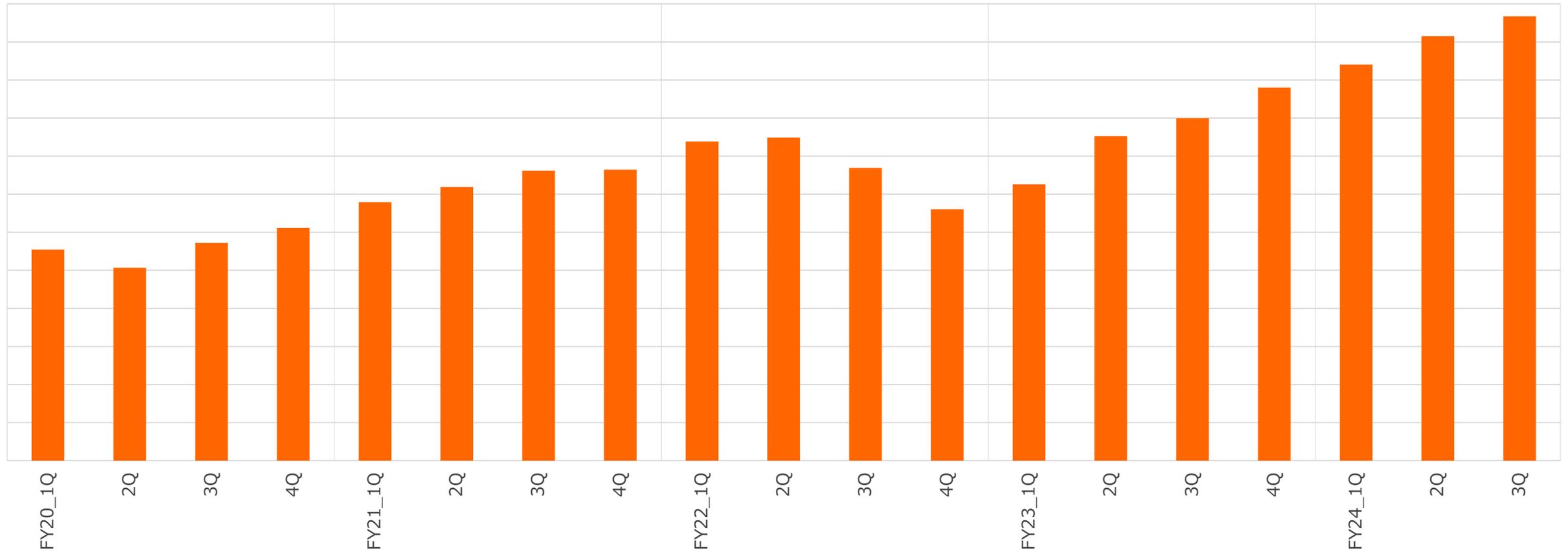
QoQ 堅調なICに加え、光半導体の増加が全体を下支え
 YoY 生成AI向けのIC、およびパワー半導体が増加

出荷額ベース

グラインダ



QoQ 生成AI向けのICに加え、光半導体、素材ウェーハの増加が全体を押し上げた
 YoY 生成AI需要の拡大によりICが増加



精密加工ツール（消耗品）の出荷は季節性による動きや為替影響により高水準で推移

| (単位：百万円) | FY2024 3Q | FY2024 2Q | 差額 |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 現金及び預金 | 263,487 | 243,571 | 19,916 |
| 受取手形・売掛金 | 42,702 | 40,586 | 2,115 |
| 棚卸資産 | 140,858 | 130,278 | 10,581 |
| 流動資産 | 456,405 | 420,812 | 35,593 |
| 有形固定資産 | 151,687 | 149,623 | 2,064 |
| 固定資産 | 172,381 | 170,185 | 2,196 |
| 総資産 | 628,786 | 590,998 | 37,789 |
| 流動負債 | 173,871 | 153,706 | 20,165 |
| 固定負債 | 821 | 763 | 58 |
| 負債合計 | 174,692 | 154,470 | 20,222 |
| 純資産 | 454,093 | 436,527 | 17,566 |
| 負債純資産合計 | 628,786 | 590,998 | 37,789 |
| 自己資本比率 | 72.0% | 73.6% | -1.6p |

総資産：主に現預金や棚卸資産が増加
 負債：主に契約負債や賞与引当金が増加
 純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：億円)

今回予想

| | FY23 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FY24 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|-------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 売上高 | 540 | 723 | 770 | 1,043 | 828 | 962 | 936 | 1,004 |
| 営業利益 | 170 | 280 | 304 | 461 | 334 | 426 | 391 | 377 |
| 経常利益 | 182 | 281 | 294 | 467 | 336 | 414 | 420 | 378 |
| 純利益 | 127 | 200 | 161 | 354 | 237 | 297 | 318 | 276 |
| 営業利益率 | 31.5% | 38.8% | 39.4% | 44.2% | 40.3% | 44.2% | 41.8% | 37.6% |
| 経常利益率 | 33.7% | 38.9% | 38.2% | 44.7% | 40.6% | 43.0% | 44.9% | 37.7% |
| 純利益率 | 23.5% | 27.7% | 20.9% | 34.0% | 28.6% | 30.9% | 34.0% | 27.5% |
| 出荷額 | 678 | 794 | 773 | 950 | 1,011 | 976 | 1,103 | 961 |

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 4Q (1-3月期)
為替感応度 (年換算)

US\$: 150円
US\$: 約15億円

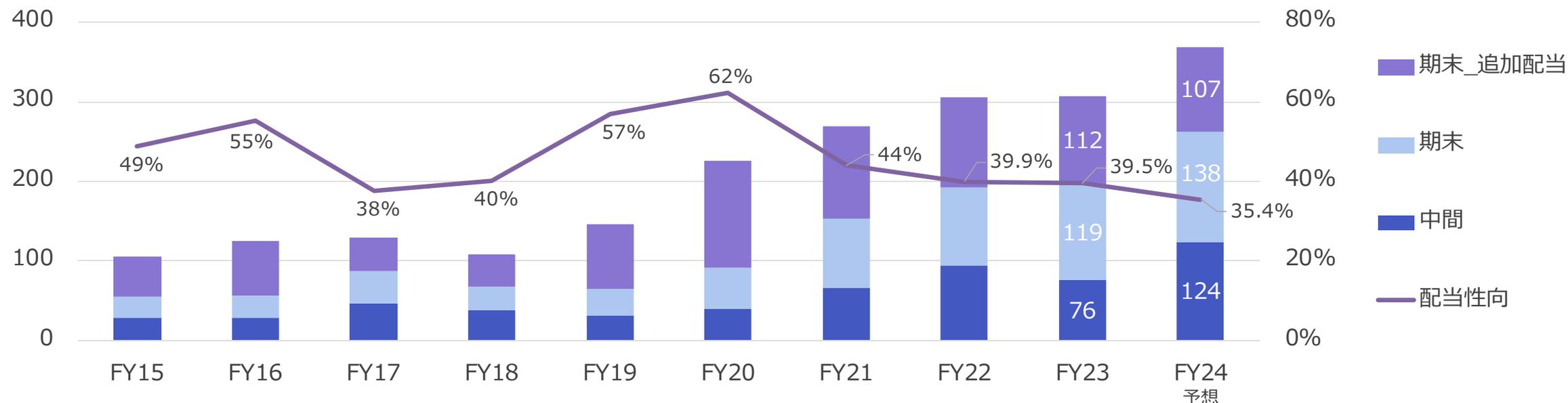
Euro : 155円
Euro : 約1億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など

(単位：円)



FY24 中間（実績）124円 期末（予想）245円

※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施
（FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載）

今回予想

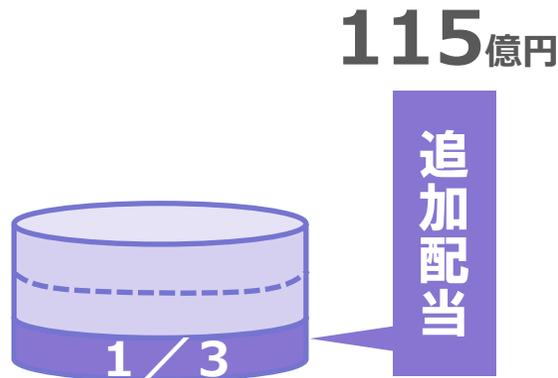
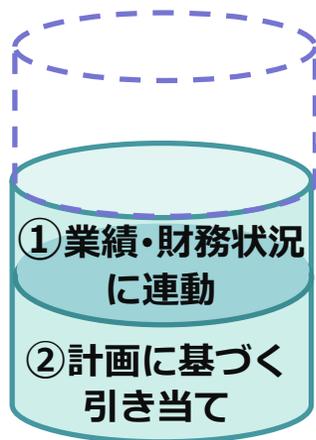
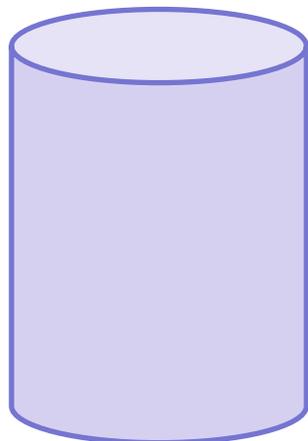
年度末現預金
1,458億円 ※

-

必要資金
1,113億円

=

余剰資金
345億円



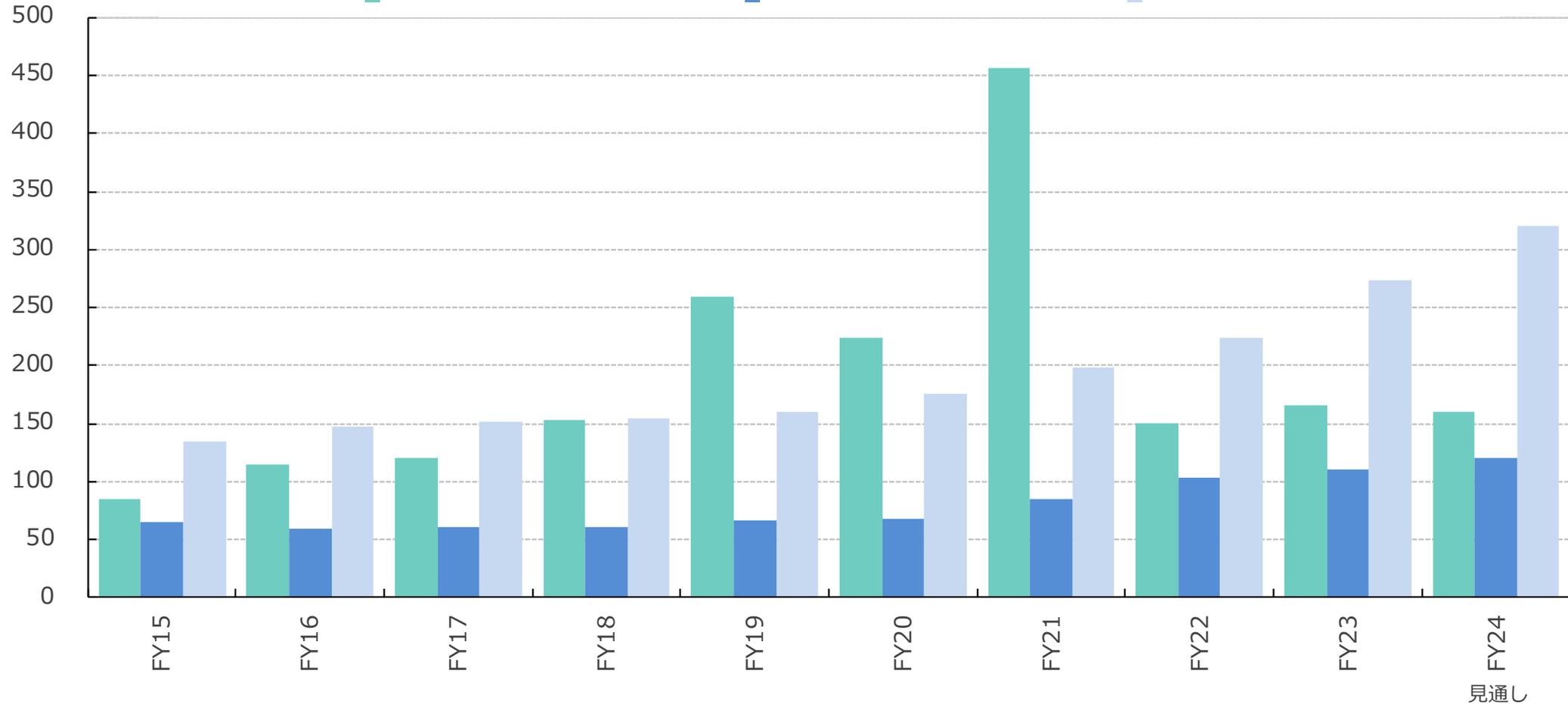
必要資金の内訳

| | | |
|---|--|------------|
| ① | 運転資金 前期 連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月 | 622 億円 |
| | 技術購入予備費(M&A含む) 連結売上高 過去3年平均 × 10% | 280 億円 |
| | 長期有利子負債 返済資金 | - |
| | 税金・配当等 | 290 億円 |
| ② | 設備拡張資金 羽田R&Dセンター建替等 | 181 億円 |
| ③ | 技術購入予備費の取り崩し | ▲260 億円 |

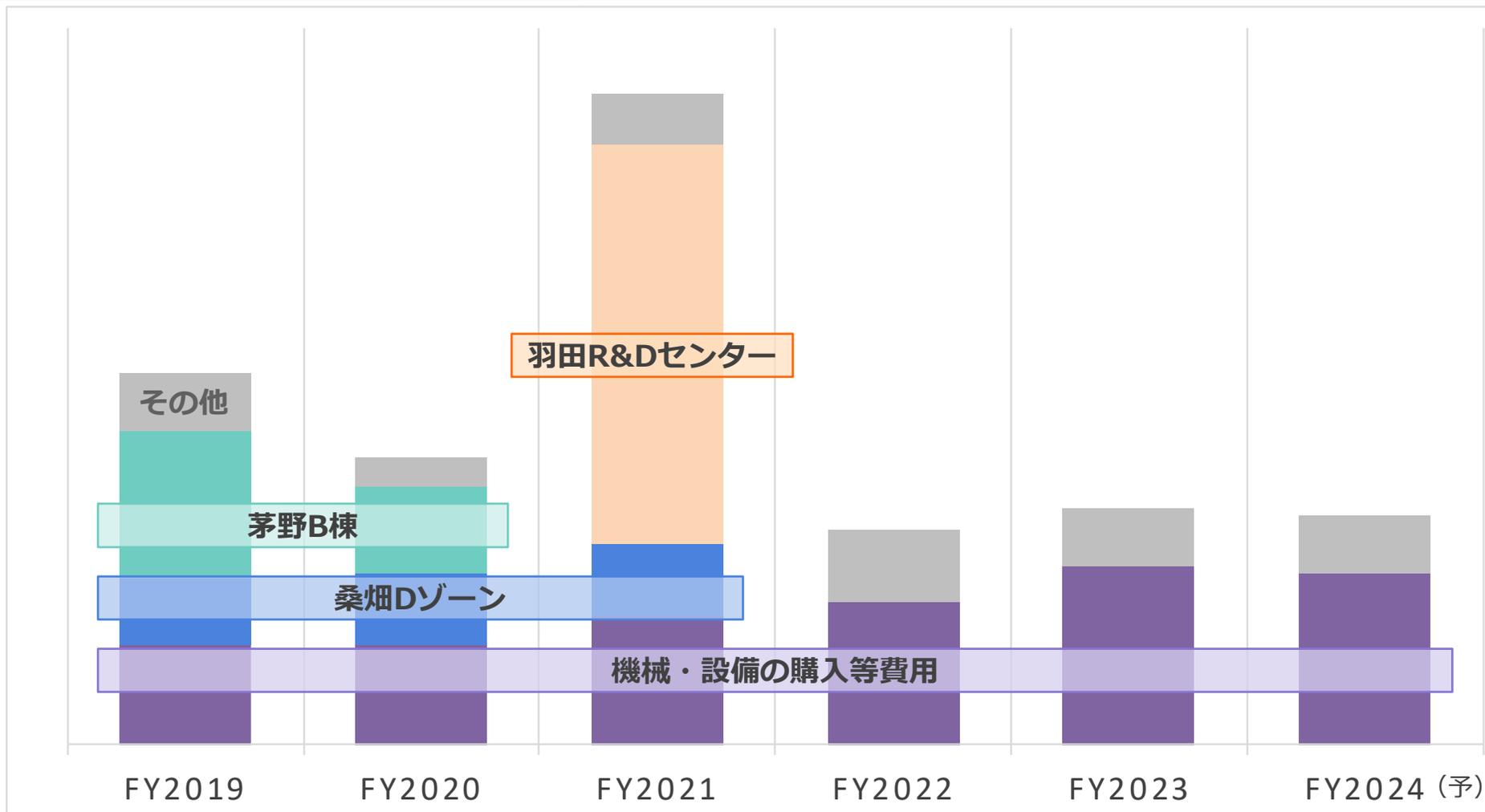
※ 契約負債（前受金）金額などを考慮

(単位：億円)

■ 設備投資 ■ 減価償却 ■ 研究開発



FY24見通し 設備投資：約160億円 主に合理化投資を実施（羽田R&Dセンター新棟はFY25着工予定）
 減価償却：約120億円 前年度と同等か若干増を見込む
 研究開発：約320億円 積極的な研究開発を継続



FY24見通し

機械・設備の購入等費用
他 オフィス拡張など

約120億円
約40億円

出荷額ベース

| 製品群 | | 見通し FY24_4Q 増減率 (QoQ) |
|---------|---------|-----------------------------|
| ダイサ | ブレードダイサ | -25% |
| | レーザーソー | 15% |
| | | -5% |
| | グラインダ | -10% |
| | 周辺装置 | 5% |
| 精密加工装置 | | -10% |
| 精密加工ツール | | -10% |
| その他 | | -35% |

【ご参考】 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

| ■ 製品群 | 構成比 | QoQ | YoY |
|----------|------|------|-----|
| | 3Q | 3Q | 3Q |
| 精密加工装置合計 | 63% | 10% | 42% |
| 内、ダイサ | 33% | 7% | 49% |
| ブレードダイサ | 18% | 33% | 50% |
| レーザソー | 15% | -14% | 49% |
| 内、グラインダ | 27% | 17% | 34% |
| 薄化DGP | 19% | 29% | 62% |
| 薄化以外 | 8% | -4% | -6% |
| 内、周辺装置 | 3% | -10% | 42% |
| 精密加工ツール | 21% | 1% | 26% |
| その他 | 16% | 53% | 74% |
| 出荷額合計 | 100% | 13% | 43% |

出荷額ベース

| 製品 | 用途 | FY23 | | | | FY24 | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 23-1Q | 23-2Q | 23-3Q | 23-4Q | 24-1Q | 24-2Q | 24-3Q |
| ダイサ | 1_IC | 38% | 40% | 60% | 61% | 67% | 69% | 60% |
| | 2_パッケージ・シンギュレーション | 6% | 4% | 2% | 4% | 4% | 3% | 6% |
| | 3_光半導体 | 12% | 12% | 7% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| | 4_その他_半導体 | 34% | 32% | 23% | 23% | 19% | 16% | 18% |
| | 5_非半導体 | 10% | 11% | 8% | 8% | 5% | 7% | 7% |
| ダイサ | | 100% |
| グラインダ | 1_IC | 32% | 41% | 48% | 52% | 60% | 61% | 62% |
| | 2_光半導体 | 5% | 7% | 12% | 1% | 6% | 1% | 8% |
| | 3_その他_半導体 | 45% | 36% | 30% | 32% | 27% | 31% | 19% |
| | 4_素材ウエーハ | 14% | 12% | 7% | 10% | 6% | 4% | 9% |
| | 5_非半導体 | 5% | 4% | 3% | 4% | 2% | 3% | 3% |
| グラインダ | | 100% |

出荷額ベース

| | | FY23 | | | | FY24 | | |
|--------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 製品 | 用途 | 23-1Q | 23-2Q | 23-3Q | 23-4Q | 24-1Q | 24-2Q | 24-3Q |
| ダイサ | 1_IC | -46% | -27% | 1% | 94% | 210% | 135% | 50% |
| | 2_パッケージ・シグネーチャ | -71% | -60% | -76% | -32% | 23% | -15% | 270% |
| | 3_光半導体 | 55% | 81% | -28% | -18% | -26% | -46% | 112% |
| | 4_その他_半導体 | 18% | 23% | -37% | 2% | -3% | -33% | 15% |
| | 5_非半導体 | 40% | 24% | -15% | 35% | -17% | -13% | 26% |
| ダイサ | | -25% | -7% | -19% | 41% | 75% | 36% | 49% |
| グラインダ | 1_IC | -23% | 25% | -11% | 69% | 160% | 68% | 73% |
| | 2_光半導体 | 253% | 207% | 267% | -81% | 46% | -86% | -15% |
| | 3_その他_半導体 | 74% | 50% | 3% | 22% | -16% | -4% | -15% |
| | 4_素材ウエーハ | 24% | 37% | -37% | -15% | -45% | -62% | 79% |
| | 5_非半導体 | 198% | 244% | 74% | -4% | -50% | -24% | 19% |
| グラインダ | | 24% | 45% | 1% | 25% | 37% | 11% | 34% |

出荷額ベース

| | | FY23 | | | | FY24 | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 製品 | 用途 | 23-1Q | 23-2Q | 23-3Q | 23-4Q | 24-1Q | 24-2Q | 24-3Q |
| ダイサ | 1_IC | -25% | 26% | 46% | 40% | 20% | -4% | -7% |
| | 2_パッケージ・シンギュレーション | -37% | -5% | -50% | 126% | 14% | -34% | 119% |
| | 3_光半導体 | 22% | 22% | -46% | 1% | 10% | -12% | 115% |
| | 4_その他_半導体 | -6% | 12% | -30% | 39% | -11% | -22% | 19% |
| | 5_非半導体 | 7% | 38% | -33% | 36% | -34% | 46% | -3% |
| ダイサ | | -13% | 20% | -3% | 39% | 8% | -7% | 7% |
| グラインダ | 1_IC | -26% | 53% | 15% | 31% | 14% | -2% | 18% |
| | 2_光半導体 | -36% | 55% | 70% | -89% | 402% | -85% | 952% |
| | 3_その他_半導体 | 21% | -3% | -20% | 30% | -17% | 10% | -29% |
| | 4_素材ウエーハ | -15% | 3% | -48% | 85% | -45% | -29% | 148% |
| | 5_非半導体 | -23% | 8% | -21% | 46% | -59% | 62% | 24% |
| グラインダ | | -9% | 19% | -3% | 20% | -1% | -4% | 17% |

検収ベース

■ 構成比

| | FY2023 | | | | FY2024 | | |
|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 日本 | 13% | 12% | 12% | 12% | 9% | 11% | 12% |
| アメリカ | 10% | 16% | 11% | 14% | 15% | 10% | 8% |
| アジア | 67% | 63% | 66% | 65% | 69% | 72% | 74% |
| シンガポール | 8% | 9% | 7% | 6% | 6% | 8% | 8% |
| 台湾 | 15% | 11% | 10% | 12% | 16% | 17% | 19% |
| 韓国 | 8% | 5% | 9% | 12% | 14% | 12% | 9% |
| 中国 ※ | 35% | 36% | 38% | 34% | 32% | 33% | 37% |
| その他 | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| ヨーロッパ | 10% | 10% | 11% | 9% | 7% | 7% | 5% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

※外資メーカー現地工場向け含む

本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY（Fiscal Year）と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。％は実際の金額を基に算出しています。

将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>